



DRAM 모듈에 맞는 애드온(add-on) 선택: 극심한 환경에 맞춘 안정적 보호

DRAM 모듈은 자동화, 항공 우주, 해양 및 극심한 환경에 있는 기타 업계에서 공통적으로 발생하는 고온, 진동, 오염물질 및 화학물질을 겪는 어려움에 직면한 환경에서 더 널리 사용되고 있습니다. 이러한 경우에, 보호를 더 높이고자 하는 요구가 커지고 있는데, 그렇지 않으면 결국에 전자 장비에 심한 손상이 발생하고 심지어 부식이나 누전이 발생할 수 있습니다.

Innodisk는 산업용 메모리 솔루션 분야의 전세계 선도 업체로서, 고품질의 DRAM 모듈을 제공하고 또한 고객사 애플리케이션의 안정성 및 성능을 보장하는 것으로 컨포멀 코팅(Conformal Coating), 사이드 필(Side Fill) 기술, 방열판(Heat Spreader) 및 러기드 클립(Rugged Clip)을 포함하여 고객사에게 안정적인 애드온(add-on) 선택 옵션을 제공합니다.

컨포멀 코팅(Conformal Coating)

컨포멀 코팅(conformal coating)은 부식, 누전, 마모 또는 기타 손상으로부터 DRAM 모듈을 보호할 수 있도록 제대로 시험된 방법입니다. 얇은 절연 층의 아크릴과 실리콘을 모듈에 적용하는 것이 오염물로부터 보호하고 제품 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다. 당사의 컨포멀 코팅(conformal coating)은 휴미실(HumiSeal)에서 공급한 최고의 재료를 사용하며 안정성 및 품질을 포함하는 IPC-A-검사 표준을 충족합니다.



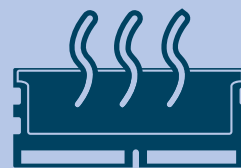
사이드 필(Side Fill) 기술



사이드 필(Side fill) 기술은 PCB 대 BGA 연결을 더 확고하게 하고, 안정성을 향상시키며, 강력한 떨림 또는 엄격한 열 주기 동안 제품 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다. DRAM IC의 세 측면에 합성 수지를 발라서 BGA 및 PCB 조인트를 강화합니다. 장력 시험은 사이드 필(side fill)이 적용된 것을 보여주며, 모듈은 최종적으로 느슨해지기 전에 힘을 최대 2배까지 견뎌냅니다.

방열판(Heat Spreader)

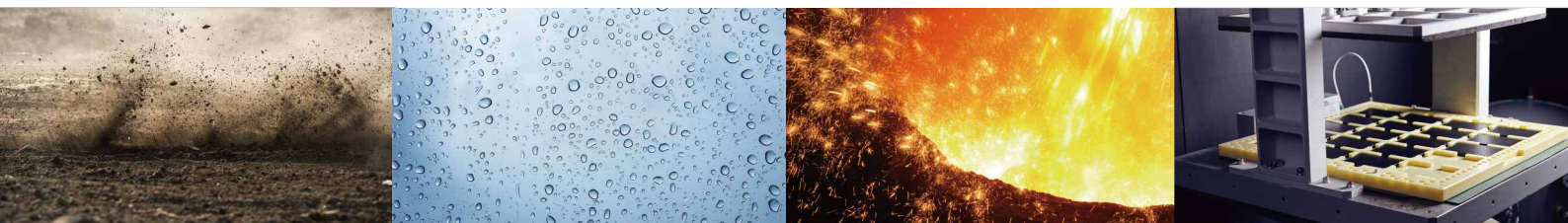
방열판(Heat spreader)은 BGA IC가 열 생성 시에 더 작아지고 더 다루기 쉬워지기 때문에 열을 잘 전달하도록 설계되었습니다. 우수한 열 방사 및 열 전도 특징 덕분에, 방열판(heat spreader)은 DRAM 모듈이 적정 온도 내에서 작동할 수 있게 만들어 주며 해당 모듈을 5%까지 냉각시켜 열을 수동적으로 분산시키는 데 도움이 됩니다. 알루미늄과 탄소 나노튜브의 두 재료 가운데 어느 것을 선택해도 무방하며, 두 재료 모두 효율적인 열 발산의 속도를 더 빠르게 강화시켜 줄 수 있습니다.



러기드 클립(Rugged Clip)



러기드 클립(rugged clip)은 떨림이 있을 때, 지속적으로 진동이 있을 때, 또한 갑작스러운 움직임이 있을 때 DRAM 모듈이 PCB 소켓에서 떨어지는 위험을 방지하는데 사용할 수 있도록 매우 안정적으로 설계되었습니다. 마더보드의 설계를 변경하지 않고도 슬롯 내부의 메모리를 안정화시키는 플렉서블한 방식입니다. 당사의 러기드 클립(rugged clip)은 고객의 어떠한 요구라도 충족시킬 수 있으며 EIA 364-28 VII의 진동 시험을 통과하였습니다.



본사

Innodisk Corporation

5F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-2-7703-3000 FAX : +886-2-7703-3555

E-mail : sales@innodisk.com